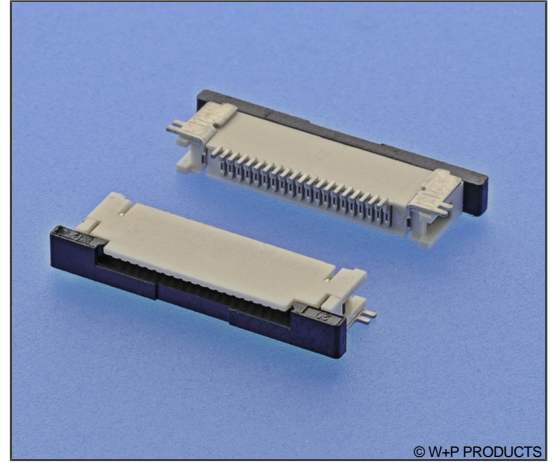


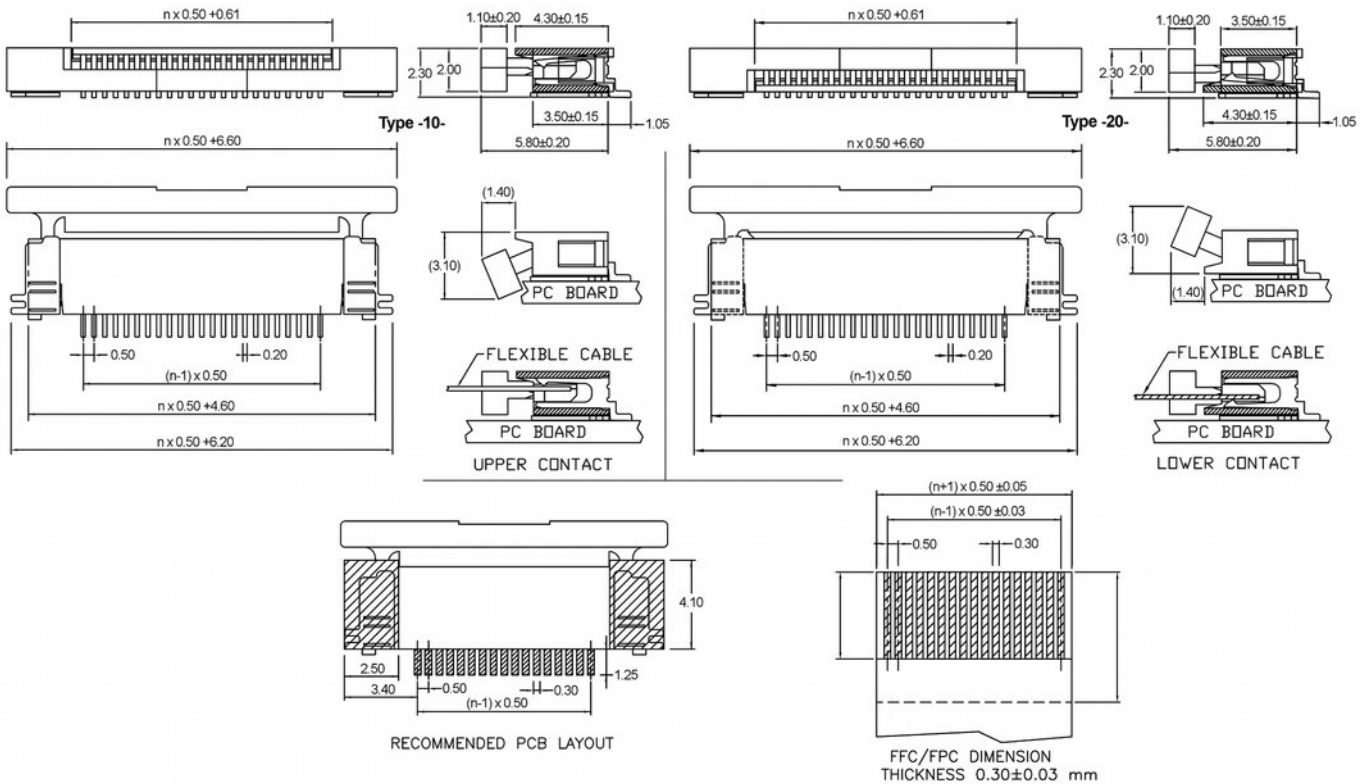
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Zinn über Nickel <i>Tin plated over nickel</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 50 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	250 V AC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	50 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	0,5 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +85 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren max. 260°C / 10sec. <i>Reflow soldering max. 260°C / 10sec.</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Flex-Kabel:  
Compatible Flexible Flat Cables:  
**599**



Series

**5578**

Contacts \*

**30**

04/06/07/08/10/11/  
12/14/15/16/18/20/  
24/26/28/30/32/34/  
36/38/40/45/50/54/  
55/60/68

Type \*

**10**

10 Kontakte oben  
Top contacts  
20 Kontakte unten  
Bottom contacts

Package

**TR**

TR Tape & Reel  
Tape & Reel

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

## Informationen zum kurzen Reflow-Lötverfahren

### Fast Profile Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Reflow Soldering Recommendation for shorter peak times

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Temperatur Lötbereich $T_L$	230°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1,5°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C max.
Dauer Höchsttemperatur	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 4,5min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Soldering Range Temperature $T_L$	230°C
Duration above $T_L$	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1.5°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C max.
Duration Peak Temperature	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 4.5min

